

與華晶的關係

與華晶成立的合營企業

華晶是於中國江蘇省無錫市創立的中國國有企業。華晶於中國成立其中一家首先創立的6英吋MOS晶圓代工廠，並為聞名的中國政府「908」行動的領導者。然而，由於不利的市況及缺乏技術，華晶的晶圓代工廠的營運面臨嚴峻考驗。於一九九八年二月，華潤上華香港在陳正宇博士的領導下開始向華晶MOS晶圓代工廠(生產5英吋及6英吋晶圓)提供晶圓代工管理服務。晶圓代工廠在華潤上華香港接手管理及改變業務模式後的業績取得重大改善。於一九九九年七月，華潤上華香港與華晶成立無錫華潤上華，旨在從事華潤上華香港於華晶MOS晶圓代工廠的晶圓代工業務。

根據華潤上華香港與華晶訂立的合營協議，除以現金注資入無錫華潤上華的註冊資本外，華潤上華香港及華晶均須進行實物注資。華潤上華香港及華晶向無錫華潤上華注入原材料、加工產品、設備及部件。此外，華晶同意向無錫華潤上華出租MOS晶圓代工廠場地、配套設施及其5英吋及6英吋設備。其後華晶及華潤上華香港更同意，根據無錫華潤上華若干產能的里程碑，透過將當時租予無錫華潤上華的若干資產及新建的6英吋晶圓代工生產線注入無錫華潤上華。華晶亦同意向無錫華潤上華提供公用設施以供晶圓代工廠作營運之用。

華潤企業及華晶收購事項

於二零零零年，華晶曾進行債務重組。於二零零二年十二月，華潤企業收購華晶全部股權，因此華晶成為華潤勵致的間接全資附屬公司，並改名為無錫華潤。無錫華潤的中介控股公司華潤微電子已承諾向本集團作出彌償保證，並承擔本集團因為或有關華晶收購事項及轉讓華晶當時所持有的無錫華潤上華的49%股權予本集團可能產生的負債及虧損，賠償最高達34,800,000美元。

於華晶收購事項完成後，無錫華潤上華的註冊資本由12,000,000美元增加至約58,000,000美元，為無錫華潤注入價值約22,500,000美元的6英吋設備，以及華潤上華香港注入現金及把未分派溢利重新投資所致。此外，上華半導體及華潤微電子已於二零零二年十二月原則上訂立協議，據此(其中包括)訂約雙方同意進行有關無錫華潤上華的重組及集資計劃。根據此項協議原則上的基準已進行重組及私人配售，詳情載於「集團歷史及最近進行的重組」。

與華潤企業的關係

關連交易

於華晶收購事項完成後，無錫華潤上華與無錫華潤於二零零三年三月訂立租賃協議（經於二零零四年六月六日訂立的補充協議補充）。根據租賃協議，於無錫華潤上華經營期間（於二零四九年七月屆滿（另行終止者則除外）），把華晶的MOS晶圓代工廠場地及配套設施租予無錫華潤上華。該租賃將於無錫華潤上華經營期間內自動重續二十年，直至二零四九年或另行予以終止為止。自華晶收購事項完成後，無錫華潤已繼續提供公用設施，如電力、飲用水、壓縮氣體、氫、空氣調節、蒸氣、消離子水及污水處理服務等予無錫華潤上華。訂約各方於二零零四年三月十九日就此安排訂立一項協議。此等交易（其中包括）將於本集團上市後構成持續關連交易。有關交易詳情載「關連交易」一節。

鑑於華潤上華香港與華晶的合營企業的歷史背景，無錫華潤上華依賴使用無錫華潤的晶圓代工廠場地及公用設施。無錫華潤上華自其成立起一直在向無錫華潤租用的MOS晶圓代工廠營運。鑑於晶圓代工廠現時已具備完善設施，而建造新晶圓代工廠的成本龐大，無錫華潤上華有意繼續履行與無錫華潤的租賃安排。根據租賃協議的條款，無錫華潤上華擁有購買晶圓代工廠場地的優先權。有關租約可於(i)訂約方相互同意；或(ii)營運配套設施、電力或水源供應持續中斷；或(iii)無錫華潤違反協議並於無錫華潤上華通知後十日內並無作出任何補救行動的情況下，方可終止。此外，在任何一方並無違約的情況下，本集團可於(i)一廠的首十年營運期間（直至二零零九年五月五日止）內給予無錫華潤五年書面通知；(ii)於第二個十年營運期間給予兩年書面通知；及(iii)其後給予一年書面通知終止租賃。由於晶圓代工廠場地位於華晶及其聯屬公司其他營運業務所在地的同一塊土地上，故無錫華潤上華需依賴華晶就整塊土地所提供的基建設施，包括電力供應變壓器及水源淨化設施。董事相信，透過無錫華潤而非外界人士取得公用設施乃更具經濟效益，並預期於未來將繼續履行公用設施供應安排。本集團與無錫華潤及其聯繫人已訂立多項協議監管租賃及公用設施供應安排及其他業務安排。有關安排為日常業務，經公平交易原則磋商後達成。董事相信，華潤勵致（於本招股章程刊發日期為本集團的單一最大股東）透過Faithway將繼續支持本集團的發展，尤其是無錫華潤上華，而無錫華潤及其聯繫人將會遵守上述協議的條款。

董事相信，倘二廠的建設工程完成，目前計劃於二零零六年完成，於本集團與華潤企業訂立的現有持續關連交易於將來會較不重要。二廠將於華潤無錫擁有的物業上興建（請參閱附錄四第一項物業）。由於二廠逐步增產，與華潤企業訂立的持續關連交易，以與一廠的營運有關為限，將會對本集團整體業務營運有較少的影響。

華潤勵致於半導體業持有的其他權益

華潤勵致透過華潤微電子持有的聯繫人(定義見上市規則,包括本集團的主要客戶之一矽科公司)亦從事半導體業務。然而,董事相信,華潤勵致並無與本集團競爭。華潤微電子於無錫擁有及經營晶圓代工廠,主要採用雙極技術生產4英吋及5英吋晶圓,本集團現時利用CMOS技術生產6英吋晶圓。雙極加工及CMOS加工的客戶規格及產品類別並不相同。此外,華潤微電子採用類似IDM業務模式,並向其客戶直接出售其「自有品牌」的雙極產品。相反,本集團為CMOS開放式晶圓代工,為需要CMOS加工程序的IC設計公司及IDM服務,而本集團並無擁有其晶圓代工廠加工的晶片設計的知識產權。

與華潤微電子訂立的不競爭承諾

緊隨完成售股後,假設全數行使認股權證所附的認購權,且超額配股權並無獲行使,華潤勵致將間接持有華潤上華已發行股本總額約23.93%。華潤勵致已表示有意持有本集團權益作長期投資。華潤微電子已向本集團承諾,在華潤微電子及其聯繫人(個人或共同)直接或間接持有本公司已發行股本20%或以上權益,並仍然為本公司單一最大股東期間,華潤微電子將不會及將促使其聯繫人不會(a)從事CMOS開放式晶圓代工製造IC的業務或(b)收購、持有或保留(就各情況而言)與本集團業務構成競爭或可能構成競爭的業務的權益。然而,概無禁止華潤微電子或其聯繫人各自或共同直接或間接持有CMOS開放式晶圓代工製造IC業務的權益,而當中(a)華潤微電子及其聯繫人並無直接或間接參與管理該項業務,或(b)華潤微電子及其聯繫人所持有的權益合共並不超過該企業已發行具投票權股本總額的15%,致使華潤微電子及其聯繫人可委任代表加入該項業務的董事會。

根據於二零零四年三月十七日訂立的彌償保證契據(請參閱附錄六「有關業務的其他資料」的「重大合約概要」第(jj)段),華潤微電子同意就與華晶收購事項,以及向本集團轉讓其所持有的無錫華潤上華的49%間接股權有關的若干風險,向本公司作出彌償保證。彌償保證風險包括任可人士持有或聲稱持有無錫華潤上華的49%股權的任何權益,或已抵押股權或附有產權負擔,或轉讓並無事先取得所需批准。華潤微電子的負債責任上限是34,800,000美元。根據彌償保證契據的條款,於二零一四年三月十八日後,本公司不得就任何索償向華潤微電子採取任何行動。